

10月28日(木)10:00-12:30	コース
KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)	
司会:中村 孝(大阪大学) ◆来賓挨拶 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作	
◆基調講演: 「令和、サプライチェーン改革下は、ニッポン半導体の 逆襲、最後で最大の機会、DXやGXに貢献を」 東京理科大学大学院経営学専攻 技術経営専攻 兼 総合研究院 MOT-FESI部門 専攻長 兼 教授 兼 部門長 若林 秀樹*	
◆基調講演 「半導体業界における人材活用と育成の実際 ~更なるイノベーションに向けたSEAJの活動」 ㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ ストラテジック・エグゼクティブ 一般社団法人日本半導体製造装置協会(SEAJ) 運営委員長 人財開発専門委員長 荒木 浩之	
◆基調講演 「半導体サプライチェーンが国家安全保障のコア ~2021年の生産額は驚異の2割増、設備投資3割増~」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉	
10月29日(金)9:30-11:55	
KM-2 マーケティングセッション 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)	
司会:松下晋司(産業タイムズ社)	
◆特別講演 「回復から本格成長に転じた半導体デバイス・装置・電子部品業界の現状と展望」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛	
◆特別講演 「世界の半導体産業の動向 ~ポストコロナで加速するDXとカーボンニュートラルで半導体産業成長シナリオが変わる~」 インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター 南川 明	
◆特別講演 「Consumer Electronics/Flat Panel Display Industry ~激動の2021~22年をどう眺むか~」 みずほ証券㈱ エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫	

【A】次世代モビリティ
【B】IoT・DX・5G/6Gの最新動向
【C】募進する半導体の世界
【D】跳躍の最先端半導体パッケージ・実装技術
【E】特別セッション

10月28日(木)14:00-16:40
A-1 拡がるモビリティの世界

松浦正純(ルネサス)/中村孝(大阪大学)
◆二輪の市場動向と電動化への展望 ㈱矢野経済研究所 モビリティ産業ユニット 上席研究員 阿江 佑宜 ◆超小型EVIによる社会的課題解決と新たな市場形成 ㈱タジマモーターコーポレーション 事業戦略推進本部 本部長 上荒穂 祥彦 ◆空飛ぶクルマの社会実装と事業化の展望 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 航空宇宙・防衛セクター/シニアマネジャー 谷本 浩隆

B-1 IoT技術の最新動向
石田昌宏(パナソニック)/加藤千晴(村田製作所)
◆デジタル時代のトランスフォーメーション ~継続的な変革に求められる取組みとは~ 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ DXビジネス推進事業部 buildサービス推進チーム チーム長 神原 宏行 ◆スケラブルなモデル学習+デプロイ手法で広がる エッジAI技術の可能性 ㈱アラヤ エンジニアリング部 エンジニア 井上 昌和 ◆大規模なアジャイル開発を実現するアーキテクチャと開発方法 ㈱BlueMeme 代表取締役社長 松岡 真功

C-1 半導体の市場・技術動向
森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)
◆ウェーハから見る 半導体市場・技術動向 ~AIを実現する半導体~ ㈱SUMCO マーケティング技術部 担当課長 小森 隆行 ◆SSD性能に観る 半導体技術 ~データセンター ストレージ技術動向~ ㈱田製作所 技術統括部 営業部 営業課 係長 伊東 容枝 ◆スバルの半導体・システム実装の技術動向 KIK Consulting & Guiding 代表 菊池 俊一

D-1 パッケージ・実装技術動向
藤原健典(東レ)/酒井滋樹(日新イオン機器)
◆Beyond 5G においてAI 性能を実現する チップレットパッケージ ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾俊彦 ◆ウェル接合を用いた異種材料集積シリコンフォトニクス最新動向 東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 竹中 充 ◆自己形成光導波路によるシリコンフォトニクスと光ファイバ間の低損失光接続技術 NTT 先端集積デバイス研究所 光電子融合研究部 光子電子システム研究グループ 研究員 齊藤 洋平

E-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム
戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)
◆2次元メタマテリアルを用いたテラヘルツ波制御 京都大学 工学研究科 電子工学専攻 量子磁工学分野 附属情報センター兼務 講師 中西俊博 ◆有機材料を用いた神経細胞機能模倣デバイスとそのAI応用に向けて 大阪大学大学院 理学研究科 教授 赤井 恵 ◆原子制御した立体構造表面でのものづくりと 立体形状が繰り返す特性 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創生化学領域 准教授 服部 賢

10月29日(金)12:50-15:05
A-2 車載実装・デバイス技術

山崎治(シャープITオートモーティブ)/佐藤高史(京都大学)
◆5G時代の自動車エレクトロニクス インターコネクション・テクノロジーズ㈱ 代表取締役 宇都宮 久修 ◆自動運転における認知・判断技術 ~センシングにおける現状と課題~ 金沢大学 高度モビリティ研究所 副所長 教授 菅沼 直樹 ◆自動運転のためのセンシングデバイスの開発状況 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ 車載事業部 車載開発部 統括部長 高橋 昌幸

B-2 デジタルトランスフォーメーションの最新動向
坂本健(NTT研究所)/中村孝(大阪大学)/石田昌宏(パナソニック)
◆バリューチェーン改革からアプローチする製造業DX Ridgeline㈱ プリンシパル オペレーションルエクセレンス 滝澤 健 ◆キーエンスの高収益を支えるデータ活用(試行錯誤の歴史) ㈱キーエンス データナリティクス事業 事業責任者 井上 泰平 ◆村田製作所の製造現場におけるIoT化と改善につながる データ活用事例 ㈱村田製作所 IoT事業推進部 m-FLIPソリューション企画開発課 シニアマネジャー 郷間 真治

C-2 装置技術・プロセス技術
三富士道彦(ローム)/廣田良浩(ワイドヴィル)
◆次世代デバイスを支えるイオン注入技術 日新イオン機器㈱ 新事業推進部 テクニカルマーケティンググループ長 黒井 隆 ◆先端半導体製造におけるフロッタツプアニール技術の活用事例 ㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ フロンティア技術統括部 統括部長 加藤 慎一* ◆次世代デバイスを支える成膜技術動向 東京エレクトロン・テクノロジソリューションズ㈱ 製品開発プロジェクト プロジェクトリーダー 柴田 哲弥

D-2 フレキシブルエレクトロニクス
森川泰宏(ULVAC)/不破保博(元ローム)
◆有機半導体が拓く新たな電子デバイスの可能性 バクリスタル㈱ 商品デザイン部 部長 平林 智貴 ◆フレキシブルエレクトロニクスで創る生体計測システム 大阪大学 産業科学研究所 教授 関谷 毅 ◆インモールド・フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)の医療応用 東北大学大学院 工学研究科 機械機能創成専攻 准教授 兼 未来科学技術共同研究センター プロジェクトリーダー 福島 晋史

E-2 蓄電デバイス
加藤千晴(村田製作所)/松下晋司(産業タイムズ社)
◆硫化物型全固体電池材料の課題と研究動向 大阪府立大学 大学院工学研究科 准教授 作田 敦 ◆メンテナンフリーIoT社会を実現する日本ガインの蓄電デバイス「EnerCera®」について~ 日本ガイン㈱ 研究開発本部 次世代技術戦略室 兼 ADC事業部 パワーデバイス部 グループマネージャー 田中 立 ◆リチウムイオン電池と次世代電池の開発 ㈱村田製作所 モジュール技術統括部 チーフマテリアルリサーチャー 永峰 政幸

10月29日(金)15:35-17:50
A-3 自動運転の最新動向

松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープITオートモーティブ)
◆協調型自動運転技術の動向 名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 所長 教授 高田 広章* ◆ADAS/ADの最新動向と市場展望 ㈱矢野経済研究所 モビリティ産業ユニット 上席部長 理事研究員 池山 智也 ◆CASEの現状と半導体動向 ㈱ミライステクノロジーズ 執行役員 篠島 靖

B-3 5G/6G技術の最新動向
戸所義博(イーセップ)/坂本健(NTT研究所)
◆5Gの先に向けたミリ波無線機の最新技術動向と課題 東京工業大学 工学院 電気電子系 教授 岡田 健一* ◆5G・6G通信で求められる高周波材料とその技術動向 MirasoLab 代表 竹田 諭司 ◆5G reconfigurable & 6Gにおけるミリ波伝搬制御に向けた Evolutionary Intelligence Surface(RIS)技術 NTT 先端集積デバイス研究所 光電子融合研究部 研究主任 来山 大祐

C-3 パワーデバイス
森義弘(SCREEN)/三富士道彦(ローム)
◆パワーデバイス向け高熱伝導材料の開発 東レ㈱ 電子情報材料研究所 主任研究員 嶋田 彰 ◆ミストドライ®法による α型酸化ガリウムパワー半導体の開発 取締役 CSO 四戸 孝 ㈱FLOSFIA ◆パワーデバイスがパワーシステム特性に与える影響を測る・予測する研究開発 ローム㈱ 研究開発センター センター長 中原 健

D-3 高密度実装
藤原健典(東レ)/森川泰宏(ULVAC)
◆半導体パッケージ向け材料の技術動向 味の素ファインテック/USA社 Business Development Manager 宮本 亮* ◆『チップレット』の現状と課題 Multi-Die Solutions/Chip-let enabling the continuous "Moore's Law" ニシダエレクトロニクス実装技術支援 代表 西田 秀行 ◆次世代BTリジン材料の紹介及び新たな基板構成の提案 三菱ガス化学㈱研究統括部 東京研究所 副主任研究員 平野 俊介

E-3 台頭する中国、躍進する韓国 ~両国のエレクトロニクス事情を探る~
中村孝(大阪大学)/山本浩之(マイクロンジャパン)
◆米中対立で変化した中国の半導体国産化戦略の最新線 ㈱産業タイムズ社 取締役副社長 電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏 ◆米中の板挟み状態にある韓国半導体&バッテリー産業 ㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 嚴 在漢*